

傳送機構

製程艙體

ULVAC SPUTTER 機台製造流程介紹：

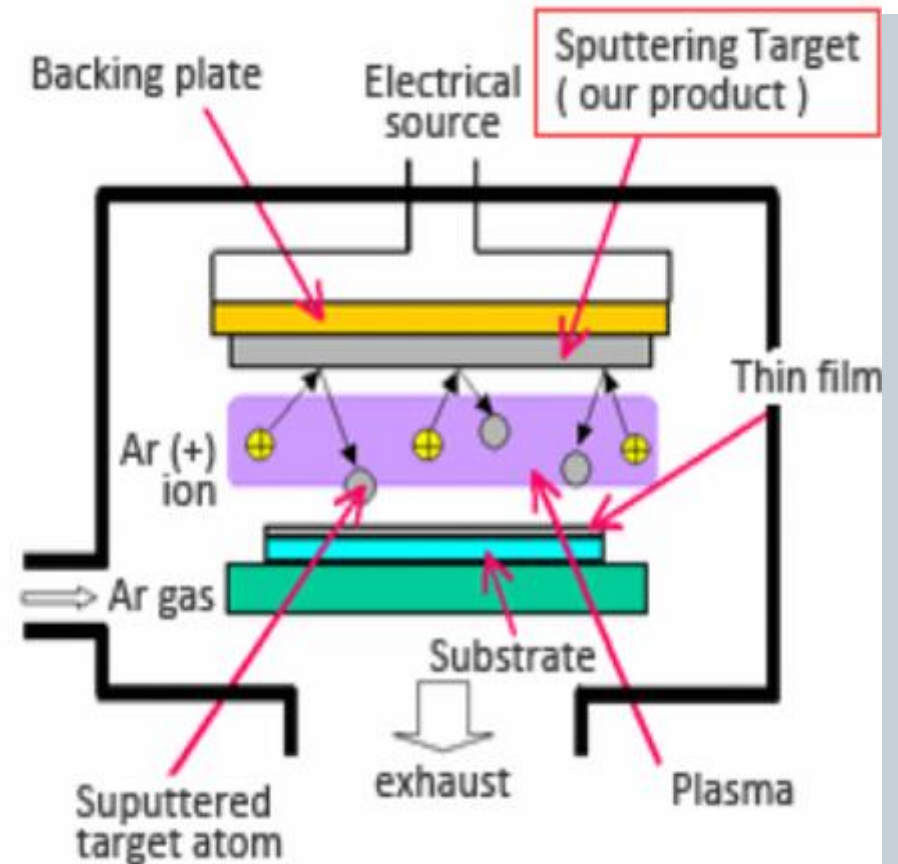
傳送機構：主要負責將晶片從晶舟取出放置於承載盤(單片式)，由承載盤依序傳送至蝕刻/濺鍍艙進行製程作業。

蝕刻作業:使用 Ar^+ 進行表面氧化鋁蝕刻。

濺鍍作業:使用單靶單艙依序作業，完成TiW / Au 濺鍍製程。

■ Sputter原理

- DC高電壓
- Ar惰性氣體
- 氣體解離
- 離子撞擊Target
- Target反濺沉積於Wafer



■ Chamber



- Load lock chamber
- Transfer chamber
- Heat chamber
- Etch chamber
- TiW₁ chamber
- TiW₂ chamber
- Au chamber



■ **Vacuum system**

- Load lock chamber : Dry pump
- H₂/Transfer chamber : Dry pump+Cryo pump
- Etch chamber : Dry pump+Tubo pump
- TiW/Au chamber : Dry pump+Tubo pump